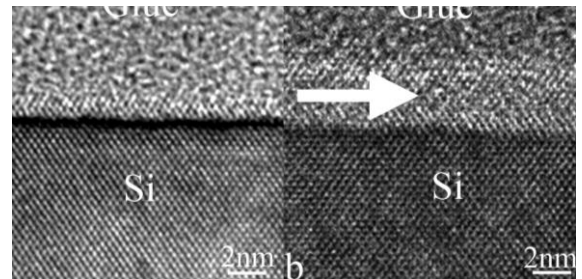
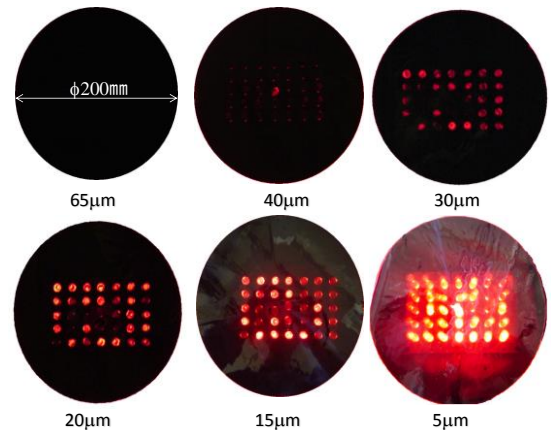


## 原子レベルの加工技術

これまでの機械加工は、主に力で原子間の結合を切り裂くことを基本としています。その影響を受けて近傍にある原子の配列が乱れてしまい、半導体など多くの機能が失われます。

本研究室では、原子間の結合を解くために光学、化学、電磁気之力(エネルギー)を応用した新しい複合加工及び計測技術を開発しています。



右図(上)、薄片加工した単結晶シリコンウエハの外観  
右図(下)、加工した単結晶シリコンウエハの原子配列

キーワード

ナノテク、半導体、超精密加工、微細加工、計測

分野

精密工学、研削加工、生産工学